Obudowy aparatów modułowych



Mi 81684

- 80 modułów: 2 x 28 modułów oraz 2 x 12 modułów

IP 65

- 3 rzędy
- Technika zacisków bezśrubowych FIXCONNECT® do PE i N
- dla każdego potencjału PE i N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
- możliwość podziału potencjału N
- do montażu urządzeń modułowych według DIN 43880
- z zaślepką zakrywającą otwór na urządzenia
- zamki pokrywy otwierane ręcznie
- z wyjmowaną konstrukcją nośną aparatów i przyłączem uziemienia
- szyny DIN mogą być uziemione
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa ochronności: II
- kolor: szary, RAL 7035

Szerokość	600 mm
Wysokość	450 mm
Głębokość	170 mm
Masa	7,856 kg

Rysunki

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 5. 2016

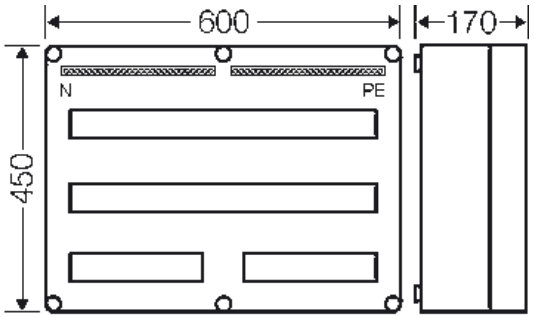
Obudowy aparatów modułowych



Mi 81684

- 80 modułów: 2 x 28 modułów oraz 2 x 12 modułów

IP 65



Rysunek wymiarowy

Obudowy aparatów modułowych

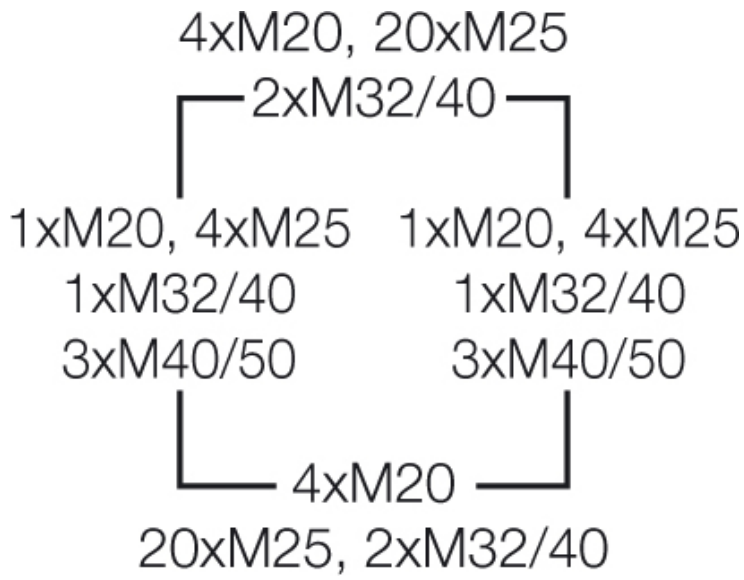


Mi 81684

- 80 modułów: 2 x 28 modułów oraz 2 x 12 modułów

IP 65

Ścianki boczne



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 5. 2016